



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100506000A

2012 年 5 月 16 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HPA(ハイパフォーマンシアナログ) PCM1801U 製品 モールド樹脂変更取消のご案内

(初版 PCN20100506000 2010 年 5 月 18 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更取消についての連絡になります。本変更は実施されません。詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。お客様の受領連絡は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

敬具

変更概要

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)		☐ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	初版連絡の下記変更内容について変更取消の連絡になります。 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) PCM1801U 製品 モールド樹脂変更 現行 : モールド樹脂 部材型番: 4205694 変更後: モールド樹脂 部材型番: 4209640			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	—			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、2010 年 5 月 18 日発行 初版 PCN20100506000 にて連絡しました下記変更予定について、変更取消の連絡になります。対象製品は、現行モールド樹脂 (部材型番: 4205694) を引き続き使用いたします。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-Malaysia(マレーシア)サイト製造 PCM1801U 製品のモールド樹脂について、現行 部材型番: 4205694 を使用して製造していますが、供給能力確保の為に、部材型番: 4209640 に変更する予定です。部材型番: 4209640 のモールド樹脂を使用した SOIC パッケージ製品は、TI-Malaysia サイトにおいて、2008 年 6 月 16 日に認定されています。下記信頼性試験結果を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

モールド樹脂 (部材型番)

現行

4205694

変更後

4209640

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名			
PCM1801U	PCM1801U/2K	PCM1801U/2KG4	PCM1801UG4

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010 年 5 月	終了	2010 年 7 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	PCM1801U	Die Size (mm):	2.27 X 3.85	
Passivation:	SiO2/ Si3N4	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/14	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	1.2 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Char.	To datasheet parameters	30	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	82	82	82
ESD-CDM	500V	15	-	-
Visual / Mechanical	-	per spec	per spec	per spec
Lead Pull	# of leads to destruction	22	22	22
Physical Dimensions	per mechanical drawing	5	5	5
Ball Bond Shear	5 units, >76 balls, 0 fails	76	76	76
Bond Pull	5 units, >76 balls, 0 fails	76	76	76
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1 /260C	12	12	12
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -1 /260C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA211ID	Die Size (mm):	1.253998 X 0.970026	
Passivation:	TEOS & Nitride	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size/ Fails
**Autoclave	For MSL Eval, 121C, 96 Hrs			77/0
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 Cycles			77/0
Manufacturability Qual	-			Approved
Delta Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C w/ CSAM deltas for pre to post reflow			22/0
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -2 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA2277U	Die Size (mm):	2.032 X 3.175	
Passivation:	5kASiO2/8kASiON	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	1.2 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Steady-state Life Test	125C,1000 Hrs (Deltas)		116/0	
Electrical Characterization	PDS Limit Verification over temp range		30/0	
High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs		77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**Temperature Cycle	-65C/150C, 1000 Cycles		77/0	
ESD-CDM	500V		3/0	
Visual / Mechanical	-		60/0	
Lead Pull	To destruction		22/0	
Flammability	Method A - UL94-0		5/0	
Flammability	Method B – IEC 695-2-2		5/0	
Flammability	Method C - UL 1694		5/0	
Manufacturability	Per mfg site specification		Approved	
**Thermal Shock	65C/150C, 1000 Cycles		77/0	
X-ray	top side only		5/0	
Delta MSL Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C w/ CSAM deltas for pre to post reflow		22/0	
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -3 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA376AID	Die Size (mm):	0.9144 X 1.1176	
Passivation:	8kASION	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	0.95 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test		Condition / Duration	Sample Size/ Fails	
**Autoclave		For MSL Eval, 121C, 96 Hrs	77/0	
**Temperature Cycle		-65C/150C, 1000 Cycles	77/0	
Manufacturability		Per mfg site specification	Approved	
Delta Moisture Sensitivity		JEDEC L-2 /260C	22/0	
Note: ** Preconditioning required. JEDEC Level -2 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 6 月 16 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA4241UA	Die Size (mm):	2.286 X 6.604	
Passivation:	5kASiO2/8kASiON	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia MLA	Package/Code/Pins:	SOIC/D/14	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	1.2 mils, Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test		Condition / Duration		Sample Size/ Fails
**Autoclave		For MSL Eval, 121C, 96 Hrs		77/0
**Temperature Cycle		-65C/150C, 1000 Cycles		77/0
Manufacturability		Per mfg site specification		Approved
Delta Moisture Sensitivity (Deltas & CSAM)		JEDEC L-3 /260C		22/0
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level -3 /260C				